OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOCTITE® SI 5089™

Tiivistysaine

LOCTITE® SI 5089™
PCB Sealant



- Tiivistysaine
- PCB Sealant
- Piirilevyn suojaukseen

TUOTEKUVAUS

LOCTITE SI 5089 on yksikomponenttinen alkoksisilikonipohjainen tiivistysaine koteloiden ja muiden rakenteiden tiivistämiseen. Materiaali kovettuu ensisijaisesti UV-valon vaikutuksesta ja muodostaa kestävän, joustavan kumimaisen tiivisteen. Se soveltuu erityisesti tuotantoprosesseihin, joissa tiivisteeltä vaaditaan nopeaa alkukovettumista.

UV-valolle altistettaessa materiaali saavuttaa toiminnallisen lujuuden lähes välittömästi. Valmistajan suosittelema alkukovetus on vähintään noin 20 sekuntia 365 nm:n UV-valolla ja vähintään 70 mW/cm²:n säteilyteholla. Lopulliset ominaisuudet kehittyvät noin 72 tunnin aikana ympäristöolosuhteissa.

UV-valolta varjoon jäävillä alueilla kovettuminen jatkuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Tämä kaksivaiheinen kovettumismekanismi helpottaa monimuotoisten rakenteiden tiivistämistä, joissa kaikki materiaali ei altistu suoralle UV-valolle.

Tiksotrooppisen koostumuksen ansiosta tiivistysaine pysyy hyvin levityskohdassa ja materiaalin liikkuminen pinnalla vähenee annostelun jälkeen. Viskositeetti on valmistajan mukaan 80 000–125 000 mPa·s lämpötilassa +25 °C. Kovettuneen materiaalin Shore A -kovuus on vähintään 25 ja murtovenymä noin 190 %, mikä tukee joustavan tiivisteen muodostumista.

LOCTITE SI 5089 fluoresoi UV-valossa, mikä helpottaa levitetyn materiaalin tarkastamista tuotantoprosessissa. Henkel ilmoittaa tyypilliseksi käyttökohteeksi erityisesti koteloiden tiivistämisen tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti kovettuvaa, jälkikäteen levitettävää tiivistettä ja mahdollisuutta välittömään visuaaliseen tarkastukseen.